



2013年3月期 決算説明会

2013年5月29日

 **ワイエイシー株式会社**

(証券コード:6298)

<http://www.yac.co.jp>

Contents

1. ご挨拶、決算のポイント

…………… 代表取締役 社長 百瀬 武文

2. 2013年3月期連結決算の概要

…………… 管理本部 経理部長 古橋 博

3. 2014年3月期連結事業計画

…………… 代表取締役 社長 百瀬 武文

4. 質疑応答



1. ご挨拶、決算のポイント

…………… 代表取締役 社長 百瀬 武文

1 決算のポイント



- 前年同期比 増収・増益。
- 受注の伸び悩み。
- 高精細パネル向け装置需要は
堅調に推移。(IGZO・4K2K対応装置)
- 金型予熱装置市場に参入。



2. 2013年3月期連結決算の概要

…………… 管理本部 経理部長 古橋 博

2-1 事業結果



(単位:百万円)

	2012年3月期	2013年3月期	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率(%)
売上高	12,378	15,048	2,670	21.6%
営業利益 (営業利益率)	181 (1.5%)	381 (2.5%)	200	110.2%
経常利益	150	311	161	107.2%
当期純利益	343	194	▲149	▲43.5%
1株当たり 当期純利益(円)	37.77	21.75	▲16.02	—
研究開発費	361	302	▲59	▲16.4%
設備投資額	159	372	212	133.1%
減価償却実施額	281	307	25	9.0%

2-2事業別売上金額



(単位:百万円)

	2012年3月期	2013年3月期	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率(%)
ハードディスク関連	2,777	2,813	36	1.3%
液晶関連	3,512	7,619	4,107	116.9%
半導体関連	682	359	▲322	▲47.3%
太陽電池関連	1,140	949	▲191	▲16.7%
FEL関連	12	1	▲11	▲91.8%
精密熱処理関連	3,049	2,010	▲1,039	▲34.1%
クリーニング関連	1,206	1,297	91	7.5%
合計	12,378	15,048	2,670	21.6%

2-3 事業別受注金額



(単位:百万円)

	2012年3月期	2013年3月期	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率(%)
ハードディスク関連	3,623	1,777	▲1,846	▲51.0%
液晶関連	7,975	7,152	▲823	▲10.3%
半導体関連	557	373	▲184	▲33.1%
太陽電池関連	911	687	▲223	▲24.5%
FEL関連	12	1	▲11	▲91.8%
精密熱処理関連	2,222	1,070	▲1,152	▲51.9%
クリーニング関連	1,206	1,297	91	7.5%
合計	16,506	12,357	▲4,148	▲25.1%

* クリーニング関連は販売計画に基づいた見込み生産のため受注=売上となります。

2-4 事業別受注残高



(単位:百万円)

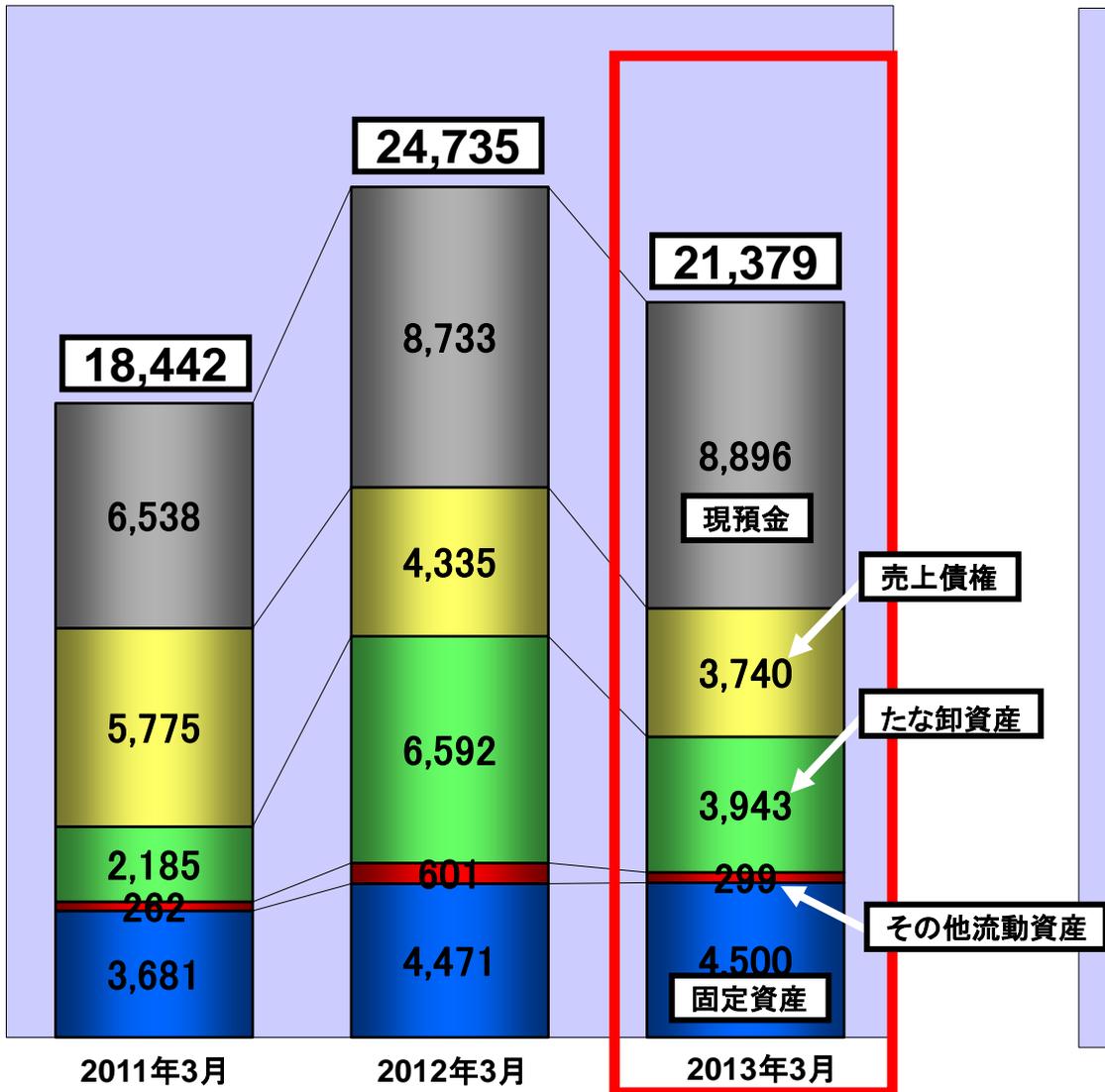
	2012年3月期	2013年3月期	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率(%)
ハードディスク関連	1,286	250	▲1,036	80.6%
液晶関連	6,224	5,757	▲467	7.5%
半導体関連	15	29	14	90.4%
太陽電池関連	477	215	▲262	▲54.9%
FEL関連	0	0	—	—
精密熱処理関連	1,053	113	▲940	89.3%
クリーニング関連	0	0	—	—
合計	9,055	6,364	▲2,690	▲29.7%

2-5 貸借対照表のレビュー



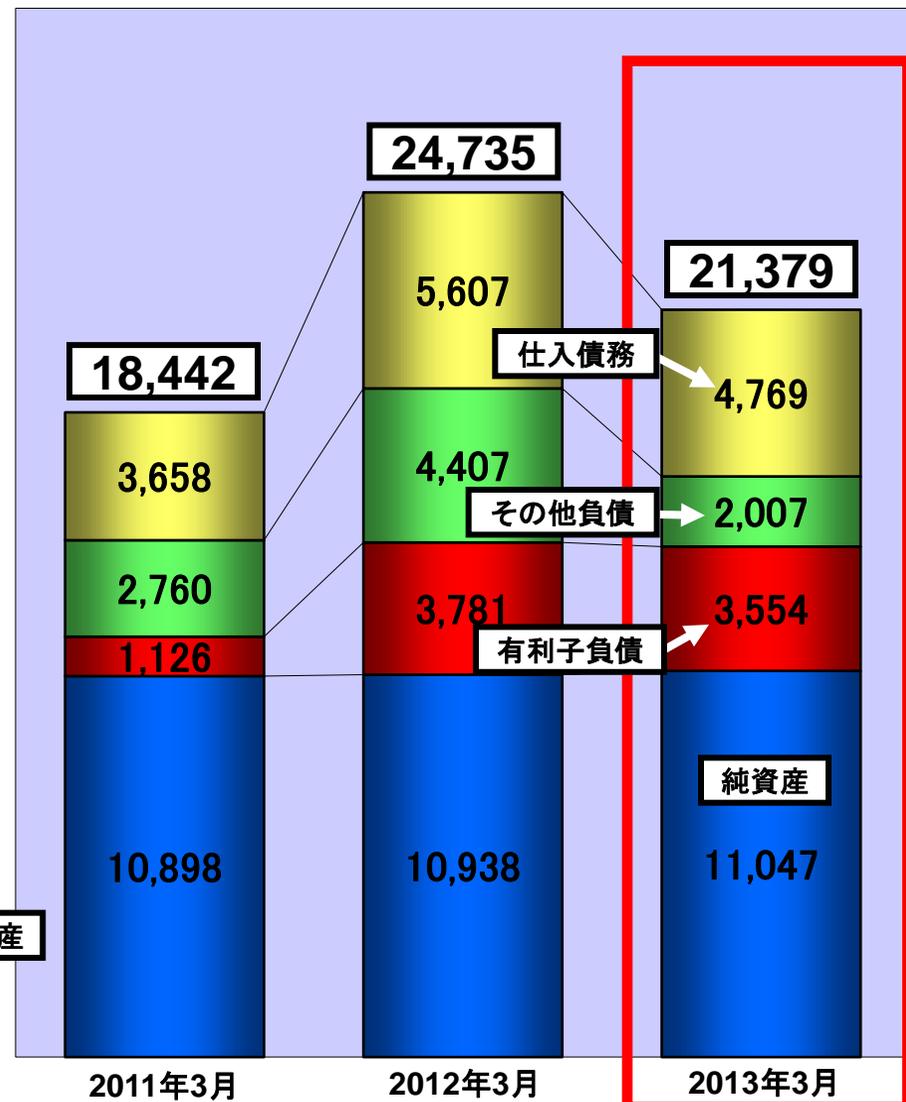
資産

(単位:百万円)



負債・純資産

(単位:百万円)



2-6 キャッシュフローのレビュー



(単位:百万円)

	2011年3月期	2012年3月期	2013年3月期
営業活動によるCF	1,854	1,760	631
投資活動によるCF	▲222	245	▲107
財務活動によるCF	▲295	131	▲602
現金及び現金同等物の 期末残高	6,520	8,637	8,761



3. 2014年3月期連結事業計画

..... 代表取締役 社長 百瀬 武文

★事業環境と重点施策

《ハードディスク関連》

- ハードディスク市場は一部を除き投資の先送りが続く
- サブストレート・ドライブ業界への深耕
- レーザースクライブ(強化ガラス)の拡販
- レーザー技術の応用(3Dプリンタ、微細穴あけ、マーキング)

《液晶関連》

- IGZO・4K2K元年(高精細かつ、大型化)
- プロセス領域の拡大により、高精細プロセスをカバー
(ドライエッチング・ウエットエッチング・アニール)
- 新プロセス技術の探求

《半導体関連》

- スマートフォン・タブレット、自動車向けは拡大
- テストハウス市場への横展開
- パワー半導体市場へ装置供給強化
- 装置ラインアップの拡大

《太陽電池関連》

- 太陽電池市場はパネル価格に加え、変換効率の高いプロセス技術を要求
- アジアを中心とした新興国へ高効率セル製造装置の販売展開
- 次世代高効率セル(HJ・N型)製造プロセスの開発、販売
- 精密洗浄のアプリケーション開発、販売

《FEL関連》

- 自動車用ランプ、UVランプの商品化

《精密熱処理関連》

- 自動車部品市場は軽量化、安全性の要求高まる
- ホットプレス関連装置の供給、拡販強化
- 金型予熱装置市場に参入
- FPD市場向けIGZOプロセスに対応精密熱処理装置を拡販

《クリーニング関連》

- 国内市場は成熟、海外市場は拡大
- 現地生産開始、現地販売強化
- 医療・介護市場への参入

★2014年3月期のキーワード★ ～ ワイエイシイの3本の矢 ～

■規模の拡大・高収益体質の確立

- ① 受注大作戦
- ② 新依命大作戦
- ③ 3Eゼロ大作戦

3-2 2014年3月期事業計画



(単位:百万円)

	2011年 3月期 (実績)	2012年 3月期 (実績)	2013年 3月期 (実績)	2014年 3月期 (見込)		前年比 増減額 (見込)	前年比 増減率 (見込)
				上期	通期		
売上高	11,498	12,378	15,048	7,000	17,000	1,952	13.0%
営業利益	699	181	381	100	800	419	109.6%
経常利益	726	150	311	70	750	439	140.9%
当期純利益	395	343	194	40	400	206	106.2%
1株当たり 当期純利益(円)	42.59	37.77	21.75	4.48	44.85	23.1	—

3-3 事業別売上計画



(単位:百万円)

	2011年 3月期 (実績)	2012年 3月期 (実績)	2013年 3月期 (実績)	2014年3月期(見込)		前年比 増減額 (見込)	前年比 増減率 (見込)
				上期	通期		
ハードディスク関連	2,611	2,777	2,813	700	2,850	37	1.3%
液晶関連	4,330	3,512	7,619	4,200	8,000	381	5.0%
半導体関連	1,257	682	359	200	600	241	67.1%
太陽電池関連	2,004	1,140	949	300	1,150	201	21.2%
FEL関連	9	12	1	0	0	▲1	—
精密熱処理関連	—	3,049	2,010	1,000	3,000	990	49.3%
クリーニング関連	1,287	1,206	1,297	600	1,400	103	7.9%
合計	11,498	12,378	15,048	7,000	17,000	1,952	13.0%

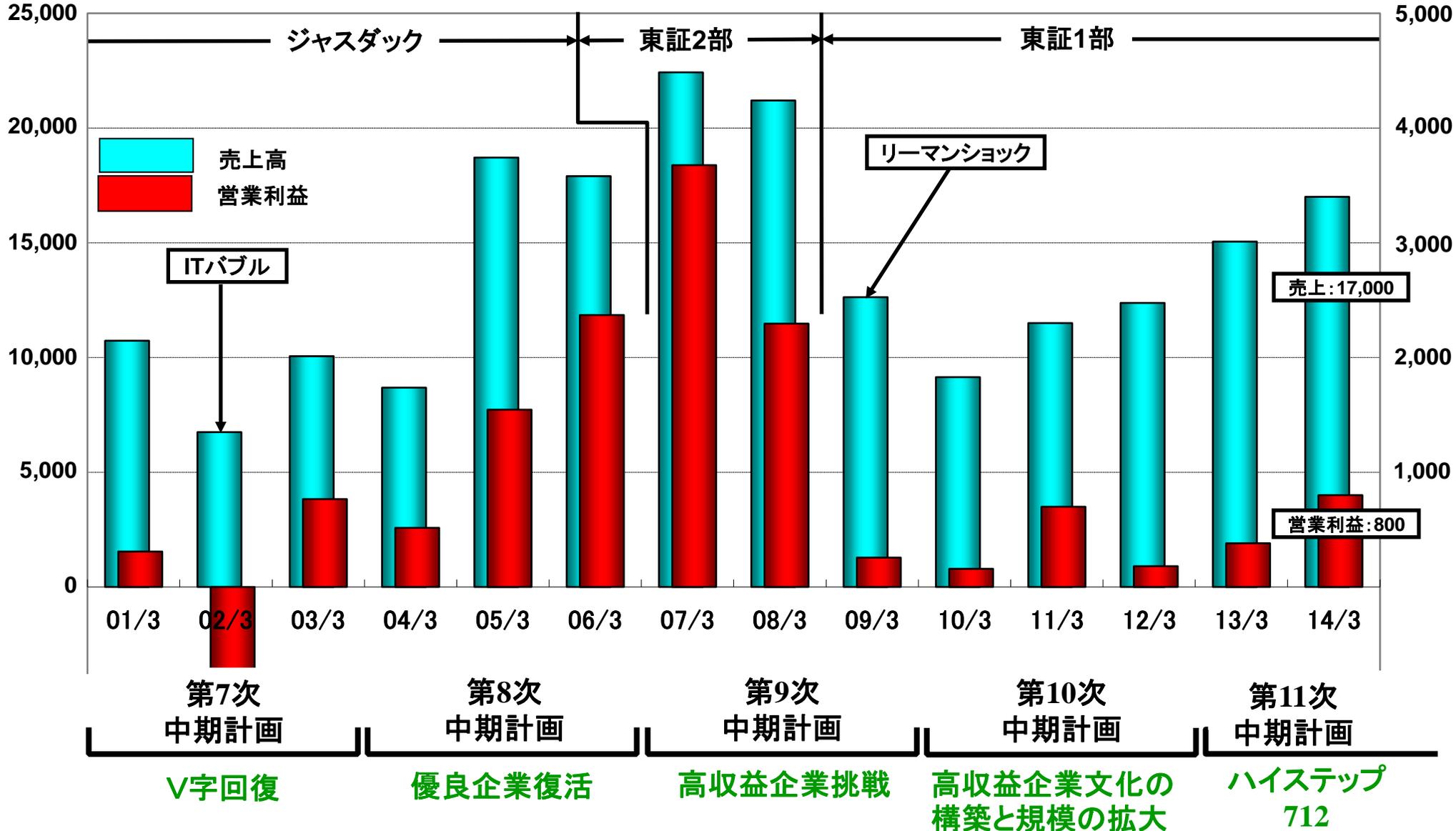
3-4 過去の業績と2014年3月期見込



売上高

(単位:百万円)

営業利益





添付資料 ワイエイシイの概要

1. 基本情報
2. ワイエイシイの特徴
3. グローバルネットワーク
4. ワイエイシイグループの構成
5. 主力製品

1 基本情報



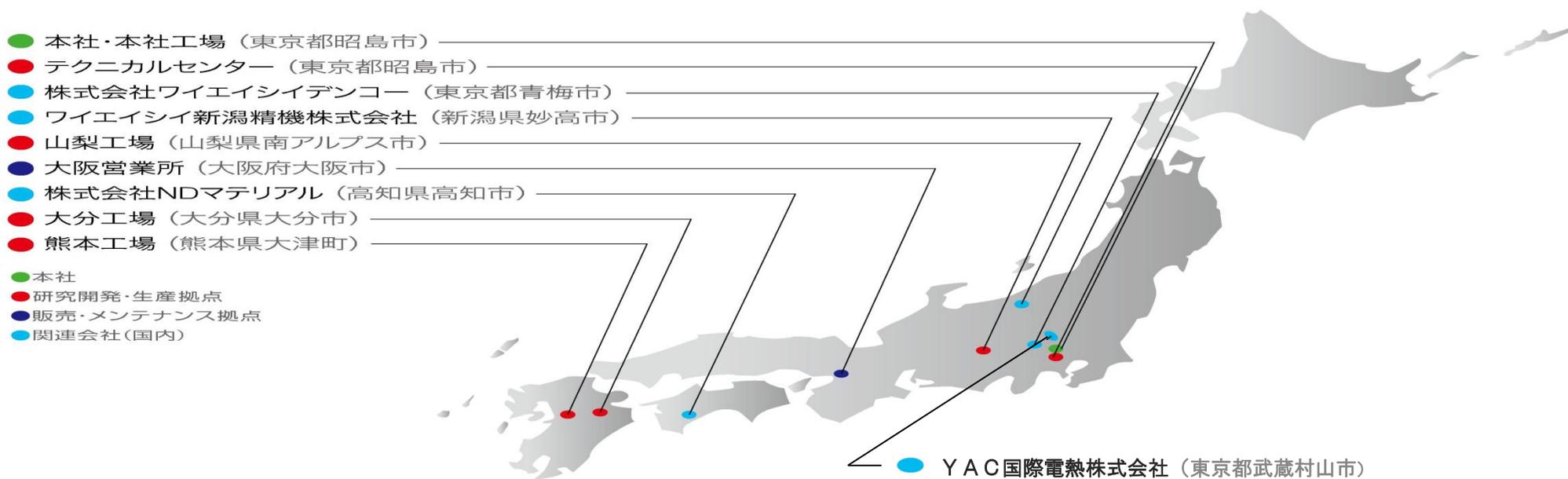
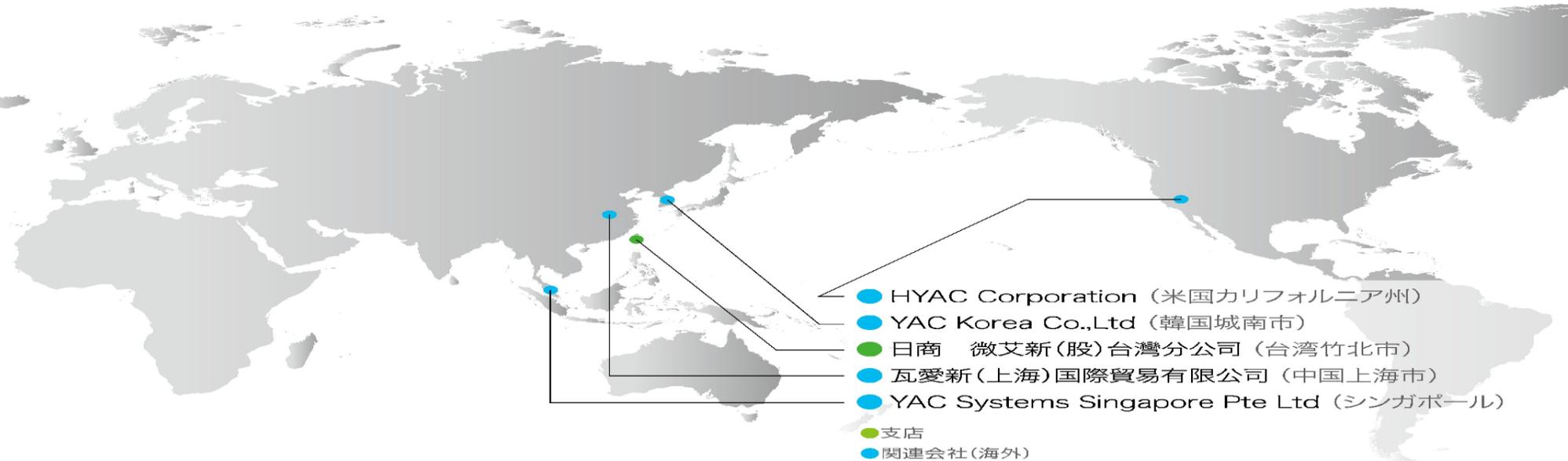
商号	ワイエイシイ株式会社
証券コード	6298 (東証1部)
設立	1973年(昭和48年)年5月
代表者	代表取締役社長 百瀬武文
事業所等	本社：東京都昭島市武蔵野3-11-10 営業所：大阪、昭島、新竹(台湾) 工場：昭島、山梨、熊本、大分
グループ会社	株式会社ワイエイシイデンコー(東京都青梅市) ワイエイシイ新潟精機株式会社(新潟県妙高市) YAC国際電熱株式会社(東京都武蔵村山市) HYAC Corporation(米国カリフォルニア州) YAC Systems Singapore Pte Ltd(シンガポール) YAC KOREA CO.,LTD(韓国城南市) 瓦愛新(上海)国際貿易有限公司(中国上海市)
投資会社	株式会社NDマテリアル
資本金	2,756百万円
事業内容	エレクトロニクス関連装置、クリーニング関連装置の 開発・設計・製造・販売
決算	3月31日

2 ワイエイシイの特徴

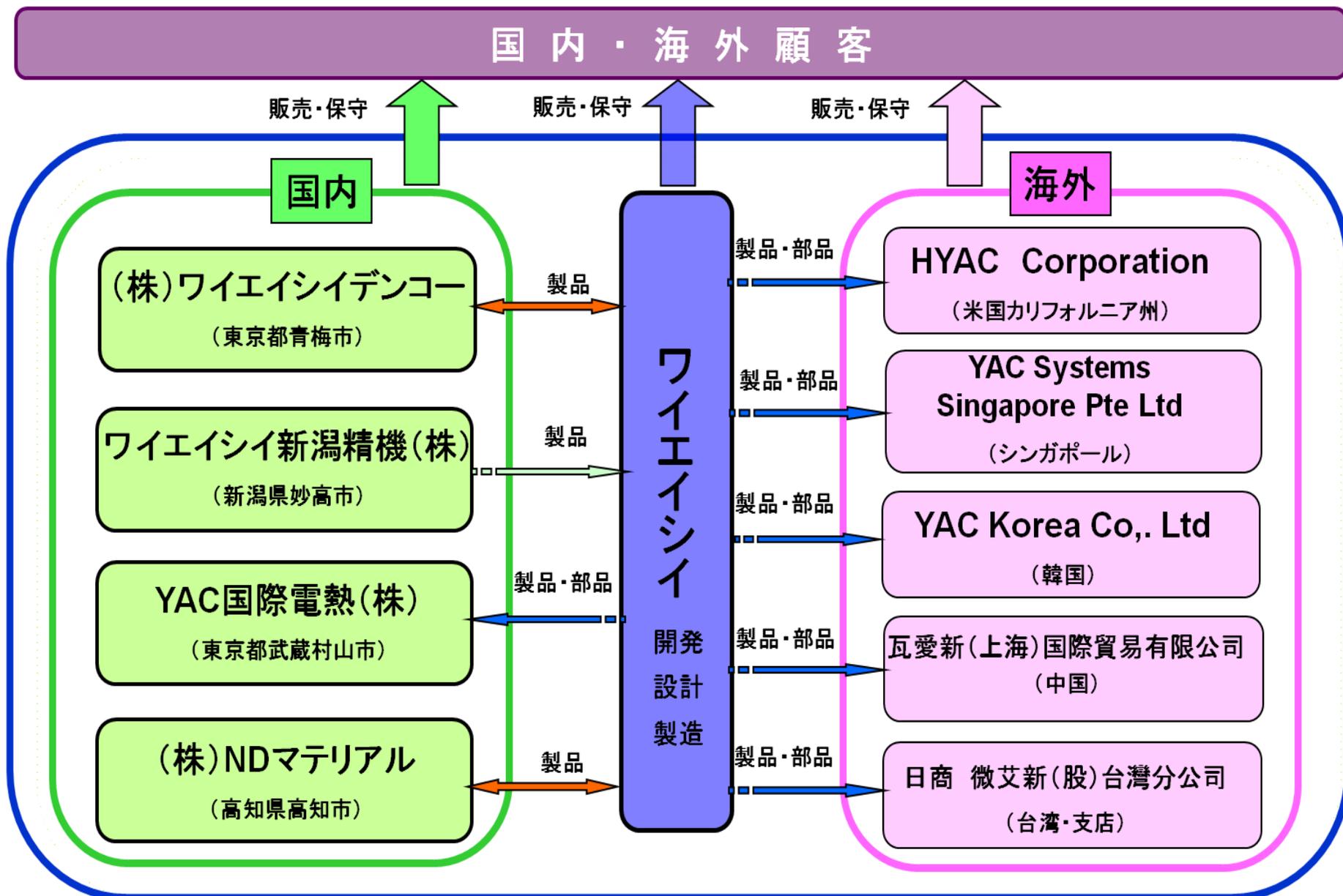


- 7分野の事業領域
- ファブレス
- M&A・アライアンス
- 製・販のグローバル化(アジアに注力)
- デバイス事業への参入
- 全員参加型経営(大討論会)
- 依命システム

3 グローバルネットワーク



4 ワイエイシイグループの構成



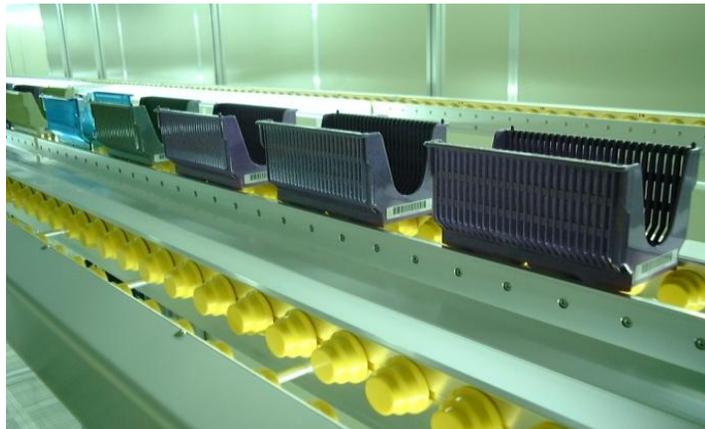
5-1 ハードディスク関連製品



バニッシャー装置	ハードディスク製造工程において、ディスクに磁性体を生成後、表面のナノオーダーの微小突起を除去する精密研磨装置
ワイピング装置	ハードディスク製造工程において、ディスクに磁性体を生成後、バニッシュ工程の前後で、表面のパーティクルの除去及び潤滑剤を表面に均一にする装置
UVキュア装置	基盤上の磁性膜面に潤滑剤(紫外線(UV)の波長に適合した潤滑剤が完成)を薄くなじませる装置
クリーンコンベア (HD工場向け)	モジュールの組み合わせで自由な搬送ライン設計が可能なローラー式コンベアAGV(自走型搬送ロボット)やOHT(天井架設型搬送装置)に比べ、搬送物をいつでも搬送ラインに投入することができ搬送効率が高い
クリーンコンベア (半導体工場向け、 太陽電池工場向け)	(同上)但し、半導体向けは搬送物が300mm用ウエハポット、太陽電池はガラス基板又は約5"ウエハが入ったカセットで、ハードディスク用に比べコンベア幅大きく、より高い耐加重性、耐衝撃性、高速搬送が要求される
クリーンコンベア (液晶工場向け)	(同上)但し、搬送物はパネルサイズに切りだされた基盤を搬送する、ハードディスク用に比べコンベア幅大きく、より高い耐加重性、耐衝撃性、高速搬送が要求される



バニッシャー



ハードディスク用クリーンコンベア



半導体用高速クリーンコンベア

5-2 液晶関連製品



プラズマドライエッチング装置

プラズマ技術を用いたドライエッチング装置
LTPS・OLEDといったスマートフォン向けの高精細加工をはじめとして、製造プロセスの効率化や省マスク技術、大型化などに最適

アニール装置

膜質の改質・改善をおこなうための熱処理装置
YHRシリーズは今後のLTPSスマートフォン・タブレットをターゲットとした高精細パネル製造に欠かせないRTA装置
LTPS高精細パネルの量産に適した装置性能を保持しており、スマートフォン・タブレットの更なる高性能化に寄与

バレル式アッシング装置

プラズマ技術を用いた国産初の半導体向けバッチ式アッシング装置
表面改質、滅菌分野など広範にわたり対応可能
PACKシリーズはポンプと発振器を専用ラックに収納可能な卓上タイプ



高密度プラズマドライエッチング装置



アニール装置 (YHRシリーズ)



バレル式アッシング装置
(PACKシリーズ)

5-3 半導体関連製品



ロジック系IC用 テストハンドラー

ICのパッケージ後の検査工程でテスターと接続して使用し、テスターからのテスト結果信号に基づきICを良品と不良品に自動選別する装置
必要に応じて精度の高い低温・高温(-55℃~155℃)下でのテストにも対応可能



C912 : 低・常・高温測定が可能なマルチタイプ、
開発用に最適



A/H343 : 4個同時測定、常・高温タイプ、
低振動、低発塵



A/H543 : 4個同時測定、常・高温タイプの高速型

5-4 太陽電池関連製品



太陽電池(結晶・多結晶) 製造装置

単結晶・多結晶型太陽電池の全ライン(インライン・バッチ方式)の製造装置

特徴

- ・テクスチャリング……………バッチ・インライン装置
- ・拡散炉……………P塗布装置・チューブ(バッチ)式・インライン装置
- ・PSG(ISO)……………バッチ・インライン装置
- ・反射防止膜(AR)成膜……………PECVD装置
- ・配線印刷……………スクリーン印刷/乾燥炉
- ・配線形成(BSF形成)……………焼成炉
- ・その他関連装置



“e-line” : PSG/ISO装置



“e-wet” : テクスチャリング装置

5-5 FEL関連製品



ナノダイヤモンド薄膜製造

金属等の材料の表面に、ナノダイヤモンド膜でコーティングしたエミッターを製作
このエミッターを用いたフィールド・エミッション・ランプ(FEL)を試作

FELの特徴

- ・従来の蛍光灯と異なり、水銀・鉛等の有害物質を使用しない
- ・LED(発光ダイオード)に比べ発熱量が少なく、冷却を必要としない(効率が良い)
- ・長寿命である
- ・色選択の自由度が高い(白色から紫外領域まで)



試作品



試作品



発光写真

5-6 精密熱処理関連製品



フラットパネルディスプレイ(FPT)用 加熱装置	液晶ディスプレイ製造用加熱装置MB・MSシリーズ、 液晶・OLEDディスプレイ製造用加熱装置MTシリーズ、 液晶ディスプレイ製造用ホットプレート式加熱装置、 液晶・OLEDディスプレイ製造用減圧乾燥装置、液晶用ウォーキングビーム式連続焼成炉
太陽電池関連装置	縦型ガラス基板加熱装置、薄膜太陽電池EVA架橋炉、縦型多段式拡散炉 ウォーキングビーム式連続乾燥炉
電子部品加熱装置	メッシュベルト搬送式連続炉(マッフル)、メッシュベルト搬送式連続炉(マッフルレス) ローラーハースキルン、電子部品用各種テスト炉
ヒーター及び関連機器	ラジアントパットヒーター (PD・GPD シリーズ) インフラ ユニ (BD・SG シリーズ) インフラ ユニットヒーター (PS・PU・PH・PM シリーズ) 各種ヒーター
自動車部品用加熱装置	自動車関連工業加熱装置(ハイテンション鋼板用)、金型加熱装置、金型予熱装置



IGZO、OLEDアニール装置



金型予熱装置



ローラーハース式加熱炉



多段式加熱炉

自動車関連ハイテンション鋼板

5-7 クリーニング関連製品



ワイシャツプレス機	ワイシャツを熱板、熱風で仕上げる装置 襟とカフス、タックと袖、およびボディを3台の装置で仕上げる高速タイプはワイシャツプレス機の定番商品 タック、袖、ボディを一体で仕上げるボディースリーブタイプもある
ウール仕上機	ジャケット、パンツ、スカートなどを仕上げる装置
自動包装機	クリーニング完了後の衣類を自動で包装する装置 ハンガーにかけたまま包装する立体タイプと、畳んだ状態で包装する平面タイプがある
アパレル関連機械	洋服の生産工程、縮絨機(生地を蒸気で安定化させる)、芯地・接着機(裁断後の生地を張り合わせる) プレス仕上げ機(完成商品のシワを取り成型する)等、各種装置をラインナップ



全自動包装機 (立体タイプ)



ワイシャツ用ボディースリーブプレス機



パンツ仕上機



ジャケット仕上機



さあ今日も、

ときめきと感動の日々であれ！

くまやか先端技術企業

 **ワイエイシー株式会社**

数字の処理について

記載されている金額は百万円未満を切り捨て、その比率については小数 第2位を四捨五入しています。

業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予数値と異なる可能性があります。